

ハイブリッドメモリキューブ・コンソーシアム、第2世代仕様をリリース

－ HMC の業界レベルでの採用を今後も推進 －

第2世代仕様の草案初版をリリース

米カリフォルニア州サンノゼ、米アイダホ州ボイシー、2014年2月18日（GLOBE NEWSWIRE） -- ハイブリッドメモリキューブ（HMC）用インタフェースの業界仕様の開発に尽力しているハイブリッドメモリキューブ・コンソーシアム（HMCC）は本日、新しいインタフェース仕様の開発を通じて、HMCのエコシステム構築、およびこの画期的なテクノロジーの業界レベルでの採用支援の確立に引き続き尽力していくことを発表しました。またHMCCは本日、120社を超えてさらに増加するコンソーシアムの利用企業に対して、新しい仕様の草案初版をリリースしました。新しい仕様は増大したデータレートをサポートし、短距離（SR）性能を10Gb/s、12.5Gb/s、15Gb/sから最大30Gb/sまで向上させています。さらに、既存の産業分類との整合性を図るために、関連チャネルモデルがSRからVSRに移行しています。また、超短距離（USR）の定義により性能が10Gb/sから最大で15Gb/sまで向上しています。

世界的なメモリ企業であるマイクロン テクノロジー（Nasdaq:MU）、サムスン電子、SK hynixにより設立されたHMCCでは、利用企業によるデータの提供および2014年5月の最終版完成を目標として、利用企業に対して広範にこの草稿の配布を開始しました。第1世代の仕様は2013年4月にリリースされており、Altera、Xilinx、Open-Silicon等の複数の開発企業および利用企業は、HMCテクノロジーを利用した製品やソリューションの設計に同仕様を活用し始めています。

Xilinxのポートフォリオおよびソリューションマーケティング担当副社長であるHugh Durdan氏は次のように述べています。「HMCの第2世代仕様を利用することにより、設計者は当社のUltraScale FPGAアーキテクチャからこれまで以上に高いパフォーマンスを引き出すことができます。現在出荷中のUltraScaleデバイスはこの仕様をサポートしており、高帯域アプリケーション向け市場に投入する際のリスクの軽減と時間短縮を実現します」

また、Alteraの製品マーケティング担当シニアディレクターであるPatrick Dorsey氏は次のように述べています。「HMCの第2世代仕様ではインタフェースのデータレートが2倍になっています。これにより、システム設計者は次世代の14nmと20nmのFPGAおよびSoCで性能向上を容易に実現することができます。当社が早い段階で評価ボードを供

給したことと、HMC デバイスと FPGA の相互運用性が証明されたことにより、お客様は HMC ベースの高性能システムの評価、開発を速やかに開始することができます」

HMCC では OEM、イネーブラおよびインテグレータが協力し、マイクロンが開発した高性能のメモリソリューションである HMC のためのオープンインターフェース規格の共同開発・実装に取り組んでいます。開発企業であるマイクロン テクノロジー、サムスン電子、Altera Corporation、ARM、IBM、マイクロソフト、Open-Silicon, Inc.、SK hynix, Inc.、Xilinx, Inc. では、新しい市場の形成と HMC の業界レベルでの採用のために利用企業との間で直接協力をおこない、共通要件をサポートしています。

業界の飛躍的進歩である HMC に使用されている先進のスルーシリコンビア (TSV) は、積み重ねられたチップを電氣的に接続する垂直なコンジットで、高性能ロジックとダイナミック RAM (DRAM) を組み合わせたものです。初の商用 HMC は、160GB/s という過去に例のないメモリ帯域幅と容量 2GB でマイクロンから現在サンプル出荷中です。ビットあたり消費電力を最大で 70 パーセント削減しており、お客様の総保有コストが劇的に低下します。

業界のリーダーや業界に影響力を有する企業において、DRAM の性能向上レートとプロセッサのデータ消費レートとの間で膨らみ続ける格差に対する待望の解決策であると認識されています。HMC の能力は現在のメモリテクノロジーからの大幅なシフトを伴うものであり、性能、パッケージング、省電力性の面で現在および近い将来のメモリアーキテクチャを大幅に超えるものになります。

HMCC に参加しましょう

HMCC における利用企業のメンバーシップは、HMC の仕様開発への参加にご関心をお持ちの全ての企業に取得していただけます。このテクノロジーの導入に関する詳細情報、技術仕様、その他のツールについては www.hybridmemorycube.org をご覧ください。

HMCC について

世界的な半導体コミュニティのトップメンバーにより設立されたハイブリッドメモリキューブ・コンソーシアム (HMCC) は、ハイブリッドメモリキューブ用インターフェースの業界仕様の開発に尽力しています。コンソーシアムの現在のメンバーは、Altera、ARM、

IBM、マイクロン テクノロジー、マイクロソフト、Open-Silicon.、サムスン、SK hynix、Xilinx 等です。HMCC の詳細については www.hybridmemorycube.org をご覧ください。

お問い合わせ先： Mary Ellen Ynes

Zeno Group for Micron
+1.650.801.7954
maryellen.ynes@zenogroup.com

John Lucas
Samsung Electronics Co., Ltd.
+1.408.544.4363
j.lucas@ssi.samsung.com